

各 位

会 社 名： 東京エレクトロン株式会社
代表者名： 代表取締役社長 河合 利樹
(コード番号: 8035 東証第 1 部)
問合せ先： 代表取締役 専務執行役員 堀 哲朗
(TEL 03-5561-7000)

(訂正) 過年度決算短信等及び有価証券報告書等の一部訂正に関するお知らせ

当社が過去に開示した決算短信及び四半期決算短信に訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、この訂正による過年度の業績への影響はありません。また、連結財務諸表及び財務諸表は適正に表示されており、訂正すべき点はありません。

また、これにともない、同期間の有価証券報告書等に係る訂正報告書につきましても、本日関東財務局へ提出いたします。

記

1. 訂正の経緯及び理由

当社米国子会社 Tokyo Electron America, Inc. (以下「TEA」といいます) におきまして、受注高及び受注残高の集計プログラムに不具合があり、これにより当社が毎四半期に公表してきた連結受注高及び連結受注残高の数値に誤りが生じていたことが判明しました。TEA が当該集計プログラムを導入した平成 17 年当時から、当社の毎四半期の連結受注高に対して 0.4%過少～1.9%過剰の範囲で誤差が生じており、これらの差額が継続して積み上がった結果、平成 28 年 6 月末における受注残高は、当社の連結受注残高の 2.8%に相当する約 104 億円が過剰に計上されておりました。

この集計プログラムは、販売系の基幹システムのデータから受注高及び受注残高を集計するために TEA が現地で開発したものであり、特定の取引事象については、受注データを二重に集計してしまう不具合が生じていました。TEA 以外では当該集計プログラムは使用しておらず、他の海外現地法人の受注高及び受注残高に誤りが無いかも調査いたしました。TEA 以外では問題がないことを確認しました。

今般、プログラム上の不具合の原因究明に至り、その誤ったロジックを修正して訂正後の受注高及び受注残高の算出を行いましたので、訂正するものであります。なお、前述のとおり、平成 17 年以降に当社が公表してきた連結受注高及び連結受注残高に誤りが認められるものの、決算短信等及び有価証券報告書等の一部訂正に関しましては、有価証券報告書等の公衆縦覧期間及び修正額の影響度に鑑み、決算短信及び有価証券報告書については過去 5 年間 (四半期決算短信及び四半期報告書については過去 3 年間) の公表分を対象とすることといたします。

2. 提出する訂正報告書

- 第 49 期 有価証券報告書
- 第 50 期 有価証券報告書
- 第 51 期第 2 四半期 四半期報告書
- 第 51 期第 3 四半期 四半期報告書
- 第 51 期 有価証券報告書
- 第 52 期第 1 四半期 四半期報告書
- 第 52 期第 2 四半期 四半期報告書
- 第 52 期第 3 四半期 四半期報告書
- 第 52 期 有価証券報告書
- 第 53 期第 1 四半期 四半期報告書
- 第 53 期第 2 四半期 四半期報告書
- 第 53 期第 3 四半期 四半期報告書
- 第 53 期 有価証券報告書
- 第 54 期第 1 四半期 四半期報告書

3. 訂正する決算短信

「平成24年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)【添付資料】2ページ及び20ページ

「平成25年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)【添付資料】2ページ及び21ページ

「平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)【添付資料】3ページ及び4ページ

「平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)【添付資料】3ページ及び4ページ

「平成26年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)【添付資料】2ページ及び24ページ

「平成27年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)【添付資料】3ページ及び4ページ

「平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)【添付資料】3ページ及び4ページ

「平成27年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)【添付資料】3ページ及び4ページ

「平成27年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)【添付資料】2ページ及び21ページ

「平成28年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)【添付資料】3ページ及び4ページ

「平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)【添付資料】3ページ及び4ページ

「平成28年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)【添付資料】3ページ及び4ページ

「平成28年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)【添付資料】2ページ及び21ページ

「平成29年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)【添付資料】3ページ及び4ページ

4. 訂正内容

訂正箇所は_____を付して表示しております。

「平成24年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の訂正

1. 経営成績 (1) 経営成績に関する分析 (2) 当連結会計年度の損益の状況 (2ページ)

(訂正前)

② 当連結会計年度の損益の状況

このような状況のもと、当連結会計年度の損益の状況は以下のとおりとなりました。

当連結会計年度の売上高は、6,330億9千1百万円(前連結会計年度比5.3%減)となりました。国内売上高が、1,713億6千4百万円(前連結会計年度比5.9%減)、海外売上高が、4,617億2千7百万円(前連結会計年度比5.1%減)となり、連結売上高に占める海外売上高の比率につきましては72.9%となりました。なお、当連結会計年度の受注高は、5,409億5千万円(前連結会計年度比26.4%減)となり、当連結会計年度末の受注残高は、2,166億6千9百万円(前連結会計年度末比29.8%減)となりました。

(訂正後)

② 当連結会計年度の損益の状況

このような状況のもと、当連結会計年度の損益の状況は以下のとおりとなりました。

当連結会計年度の売上高は、6,330億9千1百万円(前連結会計年度比5.3%減)となりました。国内売上高が、1,713億6千4百万円(前連結会計年度比5.9%減)、海外売上高が、4,617億2千7百万円(前連結会計年度比5.1%減)となり、連結売上高に占める海外売上高の比率につきましては72.9%となりました。なお、当連結会計年度の受注高は、5,405億7千7百万円(前連結会計年度比26.4%減)となり、当連結会計年度末の受注残高は、2,159億3千4百万円(前連結会計年度末比30.0%減)となりました。

4. その他 (1) 生産、受注及び販売の状況 (2) 受注実績 (20ページ)

(訂正前)

② 受注実績

(単位：百万円)

セグメントの名称	〔 前連結会計年度 自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日 〕		〔 当連結会計年度 自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日 〕	
	受注高	受注残高	受注高	受注残高
半 導 体 製 造 装 置	<u>567,971</u>	<u>228,942</u>	<u>437,615</u>	<u>188,684</u>
F P D / P V 製 造 装 置	75,433	65,491	18,598	14,200
電 子 部 品 ・ 情 報 通 信 機 器	91,035	14,375	84,276	13,783
そ の 他	453	—	461	—
合 計	<u>734,893</u>	<u>308,809</u>	<u>540,950</u>	<u>216,669</u>

(訂正後)

② 受注実績

(単位：百万円)

セグメントの名称	〔 前連結会計年度 自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日 〕		〔 当連結会計年度 自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日 〕	
	受注高	受注残高	受注高	受注残高
半 導 体 製 造 装 置	<u>567,917</u>	<u>228,581</u>	<u>437,242</u>	<u>187,950</u>
F P D / P V 製 造 装 置	75,433	65,491	18,598	14,200
電 子 部 品 ・ 情 報 通 信 機 器	91,035	14,375	84,276	13,783
そ の 他	453	—	461	—
合 計	<u>734,839</u>	<u>308,447</u>	<u>540,577</u>	<u>215,934</u>

「平成 25 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の訂正

1. 経営成績 (1) 経営成績に関する分析 ②当連結会計年度の損益の状況 (2ページ)

(訂正前)

② 当連結会計年度の損益の状況

このような状況のもと、当連結会計年度の損益の状況は以下のとおりとなりました。

当連結会計年度の売上高は、4,972億9千9百万円(前連結会計年度比21.4%減)となりました。国内売上高が1,185億3百万円(前連結会計年度比30.8%減)、海外売上高が3,787億9千5百万円(前連結会計年度比18.0%減)となり、連結売上高に占める海外売上高の比率につきましては76.2%となりました。なお、当連結会計年度の受注高は、4,506億2千7百万円(前連結会計年度比16.7%減)となり、当連結会計年度末の受注残高は、1,808億2千9百万円(前連結会計年度末比16.5%減)となりました。

(訂正後)

② 当連結会計年度の損益の状況

このような状況のもと、当連結会計年度の損益の状況は以下のとおりとなりました。

当連結会計年度の売上高は、4,972億9千9百万円(前連結会計年度比21.4%減)となりました。国内売上高が1,185億3百万円(前連結会計年度比30.8%減)、海外売上高が3,787億9千5百万円(前連結会計年度比18.0%減)となり、連結売上高に占める海外売上高の比率につきましては76.2%となりました。なお、当連結会計年度の受注高は、4,505億4千5百万円(前連結会計年度比16.7%減)となり、当連結会計年度末の受注残高は、1,800億1千3百万円(前連結会計年度末比16.6%減)となりました。

4. その他 (1) 生産、受注及び販売の状況 ②受注実績 (21ページ)

(訂正前)

②受注実績

(単位：百万円)

セグメントの名称	〔 前連結会計年度 自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日 〕		〔 当連結会計年度 自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日 〕	
	受注高	受注残高	受注高	受注残高
半 導 体 製 造 装 置	437,615	188,684	342,547	141,616
F P D / P V 製 造 装 置	18,598	14,200	21,965	24,427
電 子 部 品 ・ 情 報 通 信 機 器	84,276	13,783	85,666	14,785
そ の 他	461	—	448	—
合 計	540,950	216,669	450,627	180,829

(訂正後)

②受注実績

(単位：百万円)

セグメントの名称	〔 前連結会計年度 自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日 〕		〔 当連結会計年度 自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日 〕	
	受注高	受注残高	受注高	受注残高
半 導 体 製 造 装 置	437,242	187,950	342,466	140,800
F P D / P V 製 造 装 置	18,598	14,200	21,965	24,427
電 子 部 品 ・ 情 報 通 信 機 器	84,276	13,783	85,666	14,785
そ の 他	461	—	448	—
合 計	540,577	215,934	450,545	180,013

「平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の訂正

1. 当四半期決算に関する定性的情報 (1) 経営成績に関する説明
 (ご参考) 【生産及び受注の実績】2. 受注実績(受注高) (3ページ)、3. 受注実績(受注残高) (4ページ)

(訂正前)

2. 受注実績(受注高)

(単位:百万円)

	前期上半期	前期下半期
半導体製造装置	142,957	199,589
FPD製造装置	10,850	11,031
PV製造装置	64	19
電子部品・情報通信機器	43,290	42,376
その他	238	209
合計	197,401	253,225

当期上半期	当期	
	第1Q	第2Q
249,031	97,708	151,322
20,843	14,491	6,351
2,286	1,185	1,101
48,607	23,872	24,735
258	111	146
321,026	137,369	183,657

- (注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。
 2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

3. 受注実績(受注残高)

(単位:百万円)

	前期第2Q末	前期期末
半導体製造装置	118,702	141,616
FPD製造装置	15,885	16,005
PV製造装置	—	8,421
電子部品・情報通信機器	14,608	14,785
その他	—	—
合計	149,196	180,829

当期第1Q末	当期第2Q末
164,587	196,081
25,584	27,449
7,618	7,494
17,231	16,606
—	—
215,022	247,632

- (注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。
 2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(訂正後)

2. 受注実績(受注高)

(単位:百万円)

	前期上半期	前期下半期
半導体製造装置	142,870	199,596
FPD製造装置	10,850	11,031
PV製造装置	64	19
電子部品・情報通信機器	43,290	42,376
その他	238	209
合計	197,313	253,232

当期上半期	当期	
	第1Q	第2Q
249,152	97,715	151,436
20,843	14,491	6,351
2,286	1,185	1,101
48,607	23,872	24,735
258	111	146
321,148	137,376	183,771

- (注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。
 2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

3. 受注実績(受注残高)

(単位:百万円)

	前期第2Q末	前期期末
半導体製造装置	117,879	140,800
FPD製造装置	15,885	16,005
PV製造装置	—	8,421
電子部品・情報通信機器	14,608	14,785
その他	—	—
合計	148,373	180,013

当期第1Q末	当期第2Q末
163,779	195,386
25,584	27,449
7,618	7,494
17,231	16,606
—	—
214,214	246,937

- (注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。
 2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

「平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の訂正

1. 当四半期決算に関する定性的情報 (1) 経営成績に関する説明
 (ご参考) 【生産及び受注の実績】2. 受注実績(受注高) (3ページ)、3. 受注実績(受注残高) (4ページ)

(訂正前)

2. 受注実績 (受注高)

(単位：百万円)

	当期			
	第1Q	第2Q	第3Q	第3Q累計
半導体製造装置	97,708	151,322	143,495	392,526
FPD製造装置	14,491	6,351	3,885	24,729
PV製造装置	1,185	1,101	1,447	3,733
電子部品・情報通信機器	23,872	24,735	26,525	75,133
その他	111	146	76	334
合計	137,369	183,657	175,431	496,458

- (注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。
 2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

3. 受注実績 (受注残高)

(単位：百万円)

	当期		
	第1Q末	第2Q末	第3Q末
半導体製造装置	164,587	196,081	237,292
FPD製造装置	25,584	27,449	22,522
PV製造装置	7,618	7,494	7,744
電子部品・情報通信機器	17,231	16,606	17,102
その他	—	—	—
合計	215,022	247,632	284,663

- (注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。
 2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(訂正後)

2. 受注実績 (受注高)

(単位：百万円)

	当期			
	第1Q	第2Q	第3Q	第3Q累計
半導体製造装置	97,715	151,436	143,328	392,481
FPD製造装置	14,491	6,351	3,885	24,729
PV製造装置	1,185	1,101	1,447	3,733
電子部品・情報通信機器	23,872	24,735	26,525	75,133
その他	111	146	76	334
合計	137,376	183,771	175,264	496,412

- (注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。
 2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

3. 受注実績 (受注残高)

(単位：百万円)

	当期		
	第1Q末	第2Q末	第3Q末
半導体製造装置	<u>163,779</u>	<u>195,386</u>	<u>236,431</u>
F PD製造装置	25,584	27,449	22,522
PV製造装置	7,618	7,494	7,744
電子部品・情報通信機器	17,231	16,606	17,102
その他	—	—	—
合 計	<u>214,214</u>	<u>246,937</u>	<u>283,801</u>

(注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。
 2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

「平成 26 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の訂正

1. 経営成績 (1) 経営成績に関する分析 ②当連結会計年度の損益の状況 (2ページ)

(訂正前)

② 当連結会計年度の損益の状況

このような状況のもと、当連結会計年度の損益の状況は以下のとおりとなりました。

当連結会計年度の売上高は6,121億7千万円(前連結会計年度比23.1%増)となりました。国内売上高が1,616億3千万円(前連結会計年度比36.4%増)、海外売上高が4,505億3千9百万円(前連結会計年度比18.9%増)となり、連結売上高に占める海外売上高の比率につきましては73.6%となりました。なお、当連結会計年度の受注高は6,961億9千4百万円(前連結会計年度比54.5%増)となり、当連結会計年度末の受注残高は2,651億2千9百万円(前連結会計年度末比46.6%増)となりました。

(訂正後)

② 当連結会計年度の損益の状況

このような状況のもと、当連結会計年度の損益の状況は以下のとおりとなりました。

当連結会計年度の売上高は6,121億7千万円(前連結会計年度比23.1%増)となりました。国内売上高が1,616億3千万円(前連結会計年度比36.4%増)、海外売上高が4,505億3千9百万円(前連結会計年度比18.9%増)となり、連結売上高に占める海外売上高の比率につきましては73.6%となりました。なお、当連結会計年度の受注高は6,959億5千8百万円(前連結会計年度比54.5%増)となり、当連結会計年度末の受注残高は2,640億7千7百万円(前連結会計年度末比46.7%増)となりました。

4. その他 (1) 生産、受注及び販売の状況 ②受注実績 (24ページ)

(訂正前)

②受注実績

(単位：百万円)

セグメントの名称	〔 前連結会計年度 自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日 〕		〔 当連結会計年度 自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 〕	
	受注高	受注残高	受注高	受注残高
半 導 体 製 造 装 置	342,547	141,616	546,932	209,914
F P D 製 造 装 置	21,882	16,005	41,336	29,019
P V 製 造 装 置	83	8,421	4,303	8,994
電 子 部 品 ・ 情 報 通 信 機 器	85,666	14,785	103,141	17,200
そ の 他	448	—	479	—
合 計	450,627	180,829	696,194	265,129

(訂正後)

②受注実績

(単位：百万円)

セグメントの名称	〔 前連結会計年度 自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日 〕		〔 当連結会計年度 自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 〕	
	受注高	受注残高	受注高	受注残高
半 導 体 製 造 装 置	342,466	140,800	546,696	208,863
F P D 製 造 装 置	21,882	16,005	41,336	29,019
P V 製 造 装 置	83	8,421	4,303	8,994
電 子 部 品 ・ 情 報 通 信 機 器	85,666	14,785	103,141	17,200
そ の 他	448	—	479	—
合 計	450,545	180,013	695,958	264,077

「平成 27 年 3 月期第 1 四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の訂正

1. 当四半期決算に関する定性的情報 (1) 経営成績に関する説明
(ご参考)【生産及び受注の実績】2. 受注実績(受注高) (3ページ)、3. 受注実績(受注残高) (4ページ)

(訂正前)

2. 受注実績 (受注高)

(単位：百万円)

	前期通期					当期第1Q
	前期第1Q	前期第2Q	前期第3Q	前期第4Q		
半導体製造装置	546,932	97,708	151,322	143,495	154,405	137,297
F PD製造装置	41,336	14,491	6,351	3,885	16,607	14,280
P V製造装置	4,303	1,185	1,101	1,447	569	541
電子部品・情報通信機器	103,141	23,872	24,735	26,525	28,008	—
その他	479	111	146	76	144	167
合計	696,194	137,369	183,657	175,431	199,735	152,286

- (注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

3. 受注実績 (受注残高)

(単位：百万円)

	前期第1Q	前期第2Q	前期第3Q	前期第4Q	当期第1Q
半導体製造装置	164,587	196,081	237,292	209,914	211,085
F PD製造装置	25,584	27,449	22,522	29,019	29,371
P V製造装置	7,618	7,494	7,744	8,994	8,433
電子部品・情報通信機器	17,231	16,606	17,102	17,200	—
その他	—	—	—	—	—
合計	215,022	247,632	284,663	265,129	248,889

- (注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(訂正後)

2. 受注実績 (受注高)

(単位：百万円)

	前期通期					当期第1Q
	前期第1Q	前期第2Q	前期第3Q	前期第4Q		
半導体製造装置	546,696	97,715	151,436	143,328	154,215	136,637
F PD製造装置	41,336	14,491	6,351	3,885	16,607	14,280
P V製造装置	4,303	1,185	1,101	1,447	569	541
電子部品・情報通信機器	103,141	23,872	24,735	26,525	28,008	—
その他	479	111	146	76	144	167
合計	695,958	137,376	183,771	175,264	199,545	151,626

- (注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

3. 受注実績 (受注残高)

(単位：百万円)

	前期第1Q	前期第2Q	前期第3Q	前期第4Q	当期第1Q
半導体製造装置	163,779	195,386	236,431	208,863	209,373
F PD製造装置	25,584	27,449	22,522	29,019	29,371
P V製造装置	7,618	7,494	7,744	8,994	8,433
電子部品・情報通信機器	17,231	16,606	17,102	17,200	—
その他	—	—	—	—	—
合計	214,214	246,937	283,801	264,077	247,178

- (注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

「平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の訂正

1. 当四半期決算に関する定性的情報 (1) 経営成績に関する説明
(ご参考) 【生産及び受注の実績】 2. 受注実績(受注高) (3ページ)、 3. 受注実績(受注残高) (4ページ)

(訂正前)

2. 受注実績(受注高)

(単位:百万円)

	前期上半期	前期下半期
半導体製造装置	249,031	297,901
FPD製造装置	20,843	20,493
PV製造装置	2,286	2,017
電子部品・情報通信機器	48,607	54,533
その他	258	221
合計	321,026	375,167

当期上半期	当期	
	第1Q	第2Q
279,771	137,297	142,474
19,130	14,280	4,849
550	541	8
—	—	—
292	167	125
299,744	152,286	147,457

- (注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

3. 受注実績(受注残高)

(単位:百万円)

	前期第2Q末	前期期末
半導体製造装置	196,081	209,914
FPD製造装置	27,449	29,019
PV製造装置	7,494	8,994
電子部品・情報通信機器	16,606	17,200
その他	—	—
合計	247,632	265,129

当期第1Q末	当期第2Q末
211,085	217,059
29,371	29,121
8,433	7,219
—	—
—	—
248,889	253,399

- (注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(訂正後)

2. 受注実績(受注高)

(単位:百万円)

	前期上半期	前期下半期
半導体製造装置	249,152	297,544
FPD製造装置	20,843	20,493
PV製造装置	2,286	2,017
電子部品・情報通信機器	48,607	54,533
その他	258	221
合計	321,148	374,810

当期上半期	当期	
	第1Q	第2Q
277,148	136,637	140,511
19,130	14,280	4,849
550	541	8
—	—	—
292	167	125
297,121	151,626	145,494

- (注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

3. 受注実績(受注残高)

(単位:百万円)

	前期第2Q末	前期期末
半導体製造装置	195,386	208,863
FPD製造装置	27,449	29,019
PV製造装置	7,494	8,994
電子部品・情報通信機器	16,606	17,200
その他	—	—
合計	246,937	264,077

当期第1Q末	当期第2Q末
209,373	213,384
29,371	29,121
8,433	7,219
—	—
—	—
247,178	249,724

- (注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

「平成27年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の訂正

1. 当四半期決算に関する定性的情報 (1) 経営成績に関する説明
 (ご参考) 【生産及び受注の実績】 2. 受注実績(受注高) (3ページ)、 3. 受注実績(受注残高) (4ページ)

(訂正前)

2. 受注実績 (受注高)

(単位:百万円)

	当期			
	第1Q	第2Q	第3Q	第3Q累計
半導体製造装置	137,297	142,474	167,264	447,035
FPD製造装置	14,280	4,849	3,474	22,605
PV製造装置	541	8	1,429	1,979
その他	167	125	130	422
合計	152,286	147,457	172,298	472,042

- (注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。
 2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

3. 受注実績 (受注残高)

(単位:百万円)

	当期		
	第1Q末	第2Q末	第3Q末
半導体製造装置	211,085	217,059	252,330
FPD製造装置	29,371	29,121	28,844
PV製造装置	8,433	7,219	7,501
その他	—	—	—
合計	248,889	253,399	288,675

- (注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。
 2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(訂正後)

2. 受注実績 (受注高)

(単位:百万円)

	当期			
	第1Q	第2Q	第3Q	第3Q累計
半導体製造装置	136,637	140,511	164,320	441,468
FPD製造装置	14,280	4,849	3,474	22,605
PV製造装置	541	8	1,429	1,979
その他	167	125	130	422
合計	151,626	145,494	169,354	466,475

- (注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。
 2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

3. 受注実績 (受注残高)

(単位:百万円)

	当期		
	第1Q末	第2Q末	第3Q末
半導体製造装置	209,373	213,384	245,711
FPD製造装置	29,371	29,121	28,844
PV製造装置	8,433	7,219	7,501
その他	—	—	—
合計	247,178	249,724	282,056

- (注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。
 2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

「平成 27 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の訂正

1. 経営成績 (1) 経営成績に関する分析 ②当連結会計年度の損益の状況 (2ページ)

(訂正前)

② 当連結会計年度の損益の状況

このような状況のもと、当連結会計年度の損益の状況は以下のとおりとなりました。

当連結会計年度の売上高は6,131億2千4百万円(前連結会計年度比0.2%増)となりました。国内売上高が950億4千5百万円(前連結会計年度比41.2%減)、海外売上高が5,180億7千8百万円(前連結会計年度比15.0%増)となり、連結売上高に占める海外売上高の比率につきましては84.5%となりました。なお、当連結会計年度の受注高は6,609億6千7百万円(前連結会計年度比5.1%減)となり、当連結会計年度末の受注残高は2,957億7千1百万円(前連結会計年度末比11.6%増)となりました。

(訂正後)

② 当連結会計年度の損益の状況

このような状況のもと、当連結会計年度の損益の状況は以下のとおりとなりました。

当連結会計年度の売上高は6,131億2千4百万円(前連結会計年度比0.2%増)となりました。国内売上高が950億4千5百万円(前連結会計年度比41.2%減)、海外売上高が5,180億7千8百万円(前連結会計年度比15.0%増)となり、連結売上高に占める海外売上高の比率につきましては84.5%となりました。なお、当連結会計年度の受注高は6,549億3千7百万円(前連結会計年度比5.9%減)となり、当連結会計年度末の受注残高は2,886億8千9百万円(前連結会計年度末比9.3%増)となりました。

5. その他 (1) 生産、受注及び販売の状況 ②受注実績 (21ページ)

(訂正前)

②受注実績

(単位：百万円)

セグメントの名称	〔 前連結会計年度 自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 〕		〔 当連結会計年度 自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日 〕	
	受注高	受注残高	受注高	受注残高
半 導 体 製 造 装 置	546,932	209,914	626,795	260,467
F P D 製 造 装 置	41,336	29,019	35,301	31,611
P V 製 造 装 置	4,303	8,994	△1,684	3,692
電 子 部 品 ・ 情 報 通 信 機 器	103,141	17,200	—	—
そ の 他	479	—	555	—
合 計	696,194	265,129	660,967	295,771

(訂正後)

②受注実績

(単位：百万円)

セグメントの名称	〔 前連結会計年度 自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 〕		〔 当連結会計年度 自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日 〕	
	受注高	受注残高	受注高	受注残高
半 導 体 製 造 装 置	546,696	208,863	620,765	253,385
F P D 製 造 装 置	41,336	29,019	35,301	31,611
P V 製 造 装 置	4,303	8,994	△1,684	3,692
電 子 部 品 ・ 情 報 通 信 機 器	103,141	17,200	—	—
そ の 他	479	—	555	—
合 計	695,958	264,077	654,937	288,689

「平成 28 年 3 月期第 1 四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の訂正

1. 当四半期決算に関する定性的情報 (1) 経営成績に関する説明
(ご参考) 【生産及び受注の実績】 2. 受注実績(受注高) (3ページ)、 3. 受注実績(受注残高) (4ページ)

(訂正前)

2. 受注実績 (受注高)

(単位：百万円)

	前期通期					当期第1Q
	前期第1Q	前期第2Q	前期第3Q	前期第4Q		
半導体製造装置	626,795	137,297	142,474	167,264	179,759	156,663
F PD製造装置	35,301	14,280	4,849	3,474	12,696	11,847
その他	△1,129	708	133	1,559	△3,530	1,835
合計	660,967	152,286	147,457	172,298	188,924	170,346

- (注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

3. 受注実績 (受注残高)

(単位：百万円)

	前期第1Q	前期第2Q	前期第3Q	前期第4Q	当期第1Q
半導体製造装置	211,085	217,059	252,330	260,467	276,766
F PD製造装置	29,371	29,121	28,844	31,611	33,388
その他	8,433	7,219	7,501	3,692	201
合計	248,889	253,399	288,675	295,771	310,355

- (注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(訂正後)

2. 受注実績 (受注高)

(単位：百万円)

	前期通期					当期第1Q
	前期第1Q	前期第2Q	前期第3Q	前期第4Q		
半導体製造装置	620,765	136,637	140,511	164,320	179,296	153,465
F PD製造装置	35,301	14,280	4,849	3,474	12,696	11,847
その他	△1,129	708	133	1,559	△3,530	1,835
合計	654,937	151,626	145,494	169,354	188,462	167,148

- (注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

3. 受注実績 (受注残高)

(単位：百万円)

	前期第1Q	前期第2Q	前期第3Q	前期第4Q	当期第1Q
半導体製造装置	209,373	213,384	245,711	253,385	266,486
F PD製造装置	29,371	29,121	28,844	31,611	33,388
その他	8,433	7,219	7,501	3,692	201
合計	247,178	249,724	282,056	288,689	300,076

- (注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

「平成 28 年 3 月期第 2 四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の訂正

1. 当四半期決算に関する定性的情報 (1) 経営成績に関する説明
 (ご参考) 【生産及び受注の実績】 2. 受注実績(受注高) (3ページ)、 3. 受注実績(受注残高) (4ページ)

(訂正前)

2. 受注実績(受注高)

(単位: 百万円)

	前期上半期	前期下半期
半導体製造装置	279,771	347,023
FPD製造装置	19,130	16,170
その他	842	△1,971
合計	299,744	361,223

当期上半期	当期	
	第1Q	第2Q
279,163	156,663	122,499
24,349	11,847	12,502
2,039	1,835	204
305,552	170,346	135,206

- (注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。
 2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

3. 受注実績(受注残高)

(単位: 百万円)

	前期第2Q末	前期期末
半導体製造装置	217,059	260,467
FPD製造装置	29,121	31,611
その他	7,219	3,692
合計	253,399	295,771

当期第1Q末	当期第2Q末
276,766	222,643
33,388	37,686
201	44
310,355	260,373

- (注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。
 2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(訂正後)

2. 受注実績(受注高)

(単位: 百万円)

	前期上半期	前期下半期
半導体製造装置	277,148	343,617
FPD製造装置	19,130	16,170
その他	842	△1,971
合計	297,121	357,816

当期上半期	当期	
	第1Q	第2Q
276,291	153,465	122,825
24,349	11,847	12,502
2,039	1,835	204
302,680	167,148	135,532

- (注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。
 2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

3. 受注実績(受注残高)

(単位: 百万円)

	前期第2Q末	前期期末
半導体製造装置	213,384	253,385
FPD製造装置	29,121	31,611
その他	7,219	3,692
合計	249,724	288,689

当期第1Q末	当期第2Q末
266,486	212,689
33,388	37,686
201	44
300,076	250,419

- (注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。
 2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

「平成28年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の訂正

1. 当四半期決算に関する定性的情報 (1) 経営成績に関する説明
 (ご参考) 【生産及び受注の実績】 2. 受注実績(受注高) (3ページ)、 3. 受注実績(受注残高) (4ページ)

(訂正前)

2. 受注実績 (受注高)

(単位：百万円)

	当期			
	第1Q	第2Q	第3Q	第3Q累計
半導体製造装置	156,663	122,499	159,307	438,470
FPD製造装置	11,847	12,502	13,947	38,297
その他	1,835	204	492	2,531
合計	170,346	135,206	173,747	479,299

- (注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。
 2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

3. 受注実績 (受注残高)

(単位：百万円)

	当期		
	第1Q末	第2Q末	第3Q末
半導体製造装置	276,766	222,643	235,426
FPD製造装置	33,388	37,686	39,908
その他	201	44	13
合計	310,355	260,373	275,348

- (注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。
 2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(訂正後)

2. 受注実績 (受注高)

(単位：百万円)

	当期			
	第1Q	第2Q	第3Q	第3Q累計
半導体製造装置	153,465	122,825	157,962	434,253
FPD製造装置	11,847	12,502	13,947	38,297
その他	1,835	204	492	2,531
合計	167,148	135,532	172,402	475,082

- (注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。
 2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

3. 受注実績 (受注残高)

(単位：百万円)

	当期		
	第1Q末	第2Q末	第3Q末
半導体製造装置	266,486	212,689	224,127
FPD製造装置	33,388	37,686	39,908
その他	201	44	13
合計	300,076	250,419	264,050

- (注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。
 2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

「平成 28 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の訂正

1. 経営成績 (1) 経営成績に関する分析 ②当連結会計年度の損益の状況 (2ページ)

(訂正前)

② 当連結会計年度の損益の状況

このような状況のもと、当連結会計年度の損益の状況は以下のとおりとなりました。

当連結会計年度の売上高は6,639億4千8百万円(前連結会計年度比8.3%増)となりました。国内売上高が1,218億7百万円(前連結会計年度比28.2%増)、海外売上高が5,421億4千万円(前連結会計年度比4.6%増)となり、連結売上高に占める海外売上高の比率につきましては81.7%となりました。なお、当連結会計年度の受注高は6,793億2千万円(前連結会計年度比2.8%増)となり、当連結会計年度末の受注残高は3,111億4千3百万円(前連結会計年度末比5.2%増)となりました。

(訂正後)

② 当連結会計年度の損益の状況

このような状況のもと、当連結会計年度の損益の状況は以下のとおりとなりました。

当連結会計年度の売上高は6,639億4千8百万円(前連結会計年度比8.3%増)となりました。国内売上高が1,218億7百万円(前連結会計年度比28.2%増)、海外売上高が5,421億4千万円(前連結会計年度比4.6%増)となり、連結売上高に占める海外売上高の比率につきましては81.7%となりました。なお、当連結会計年度の受注高は6,759億8千万円(前連結会計年度比3.2%増)となり、当連結会計年度末の受注残高は3,007億2千1百万円(前連結会計年度末比4.2%増)となりました。

4. その他 (1) 生産、受注及び販売の状況 ②受注実績 (21ページ)

(訂正前)

②受注実績

(単位：百万円)

セグメントの名称	〔 前連結会計年度 自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日 〕		〔 当連結会計年度 自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日 〕	
	受注高	受注残高	受注高	受注残高
半 導 体 製 造 装 置	626,795	260,467	626,275	273,710
F P D 製 造 装 置	35,301	31,611	50,503	37,428
そ の 他	△1,129	3,692	2,541	4
合 計	660,967	295,771	679,320	311,143

(訂正後)

②受注実績

(単位：百万円)

セグメントの名称	〔 前連結会計年度 自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日 〕		〔 当連結会計年度 自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日 〕	
	受注高	受注残高	受注高	受注残高
半 導 体 製 造 装 置	620,765	253,385	622,935	263,288
F P D 製 造 装 置	35,301	31,611	50,503	37,428
そ の 他	△1,129	3,692	2,541	4
合 計	654,937	288,689	675,980	300,721

「平成 29 年 3 月期第 1 四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の訂正

1. 当四半期決算に関する定性的情報 (1) 経営成績に関する説明
 (ご参考) 【生産及び受注の実績】 2. 受注実績(受注高) (3ページ)、 3. 受注実績(受注残高) (4ページ)

(訂正前)

2. 受注実績 (受注高)

(単位：百万円)

	前期通期					当期第1Q
	前期第1Q	前期第2Q	前期第3Q	前期第4Q		
半導体製造装置	626,275	156,663	122,499	159,307	187,804	197,470
F PD製造装置	50,503	11,847	12,502	13,947	12,206	15,955
その他	2,541	1,835	204	492	9	111
合計	679,320	170,346	135,206	173,747	200,020	213,538

- (注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。
 2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

3. 受注実績 (受注残高)

(単位：百万円)

	前期第1Q	前期第2Q	前期第3Q	前期第4Q	当期第1Q
半導体製造装置	276,766	222,643	235,426	273,710	340,384
F PD製造装置	33,388	37,686	39,908	37,428	36,319
その他	201	44	13	4	1
合計	310,355	260,373	275,348	311,143	376,704

- (注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。
 2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(訂正後)

2. 受注実績 (受注高)

(単位：百万円)

	前期通期					当期第1Q
	前期第1Q	前期第2Q	前期第3Q	前期第4Q		
半導体製造装置	622,935	153,465	122,825	157,962	188,681	197,496
F PD製造装置	50,503	11,847	12,502	13,947	12,206	15,955
その他	2,541	1,835	204	492	9	111
合計	675,980	167,148	135,532	172,402	200,897	213,564

- (注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。
 2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

3. 受注実績 (受注残高)

(単位：百万円)

	前期第1Q	前期第2Q	前期第3Q	前期第4Q	当期第1Q
半導体製造装置	266,486	212,689	224,127	263,288	329,988
F PD製造装置	33,388	37,686	39,908	37,428	36,319
その他	201	44	13	4	1
合計	300,076	250,419	264,050	300,721	366,309

- (注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。
 2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。